2021-2026年中国高端芯片市场全面调研及行业投资潜力预测报告

报告大纲

华经情报网
www.huaon.com

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国高端芯片市场全面调研及行业投资潜力预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.huaon.com//channel/electric/738026.html

报告价格：电子版: 9000元　纸介版：9000元　电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

集成电路中性能比较高、应用面比较广的核心芯片。如高性能中央处理器（CPU）芯片、高性能数字信号处理芯片（DSP）和高端系统级芯片（SOC）等。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录：
第一章 高端芯片行业相关概述
1.1 芯片相关介绍
1.1.1 基本概念
1.1.2 摩尔定律
1.1.3 芯片分类
1.1.4 产业链条
1.1.5 商业模式
1.2 高端芯片相关概述
1.2.1 高端概念界定
1.2.2 高级逻辑芯片
1.2.3 高级存储芯片
1.2.4 高级模拟芯片
1.2.5 芯片进程发展
第二章 2016-2020年国际高端芯片行业发展综合分析
2.1 2016-2020年全球芯片行业发展情况分析
2.1.1 全球经济形势分析
2.1.2 全球芯片销售规模
2.1.3 全球芯片区域市场
2.1.4 全球芯片产业分布
2.1.5 全球芯片细分市场
2.1.6 全球芯片需求现状
2.1.7 全球芯片重点企业
2.2 2016-2020年全球高端芯片行业现况分析
2.2.1 高端芯片市场现状
2.2.2 高端逻辑芯片市场
2.2.3 高端存储芯片市场

2.3 2016-2020年美国高端芯片行业发展分析
2.3.1 美国芯片发展现状
2.3.2 美国芯片市场结构
2.3.3 美国主导芯片供应
2.3.4 美国芯片相关政策
2.4 2016-2020年韩国高端芯片行业发展分析
2.4.1 韩国芯片发展现状
2.4.2 韩国芯片市场分析
2.4.3 韩国芯片发展问题
2.4.4 韩国芯片发展经验
2.5 2016-2020年日本高端芯片行业发展分析
2.5.1 日本芯片市场现状
2.5.2 日本芯片竞争优势
2.5.3 日本芯片国家战略
2.5.4 日本芯片发展经验
2.6 2016-2020年中国台湾高端芯片行业发展分析
2.6.1 中国台湾芯片发展现状
2.6.2 中国台湾芯片市场规模
2.6.3 中国台湾芯片产业链布局
2.6.4 台湾与大陆产业优势互补
2.6.5 美国对台湾芯片发展影响
第三章 2016-2020年中国高端芯片行业发展环境分析
3.1 政策环境
3.1.1 智能制造行业政策
3.1.2 行业监管主体部门
3.1.3 行业相关政策汇总
3.1.4 集成电路税收政策
3.2 经济环境
3.2.1 宏观经济概况
3.2.2 对外经济分析
3.2.3 工业经济运行
3.2.4 固定资产投资
3.2.5 宏观经济展望
3.2.6 中美科技战影响
3.3 投融资环境

3.3.1 美方制裁加速投资
3.3.2 社会资本推动作用
3.3.3 大基金投融资情况
3.3.4 地方政府产业布局
3.3.5 设备资本市场情况
3.4 人才环境
3.4.1 需求现状概况
3.4.2 人才供需失衡
3.4.3 创新人才紧缺
3.4.4 培养机制不健全
第四章 2016-2020年中国高端芯片行业综合分析
4.1 2016-2020年中国芯片行业发展业态
4.1.1 芯片市场发展规模
4.1.2 芯片细分产品业态
4.1.3 芯片设计行业发展
4.1.4 芯片制造行业发展
4.1.5 芯片封测行业发展
4.2 2016-2020年中国高端芯片发展情况
4.2.1 高端芯片行业发展现状
4.2.2 高端芯片细分产品发展
4.2.3 高端芯片技术发展方向
4.3 中国高端芯片行业发展问题
4.3.1 芯片产业核心技术问题
4.3.2 芯片产业生态构建问题
4.3.3 高端芯片资金投入问题
4.3.4 国产高端芯片制造问题
4.4 中国高端芯片行业发展建议
4.4.1 尊重市场发展规律
4.4.2 上下环节全面发展
4.4.3 加强全球资源整合
第五章 2016-2020年高性能CPU行业发展分析
5.1 CPU相关概述
5.1.1 CPU基本介绍
5.1.2 CPU主要分类
5.1.3 CPU的指令集

5.1.4 CPU的微架构
5.2 高性能CPU技术演变
5.2.1 CPU总体发展概述
5.2.2 指令集更新与优化
5.2.3 微架构的升级过程
5.3 CPU市场发展情况分析
5.3.1 产业链条结构分析
5.3.2 全球高端CPU供需分析
5.3.3 国产高端CPU发展现状
5.3.4 国产高端CPU市场前景
5.4 CPU细分市场发展分析
5.4.1 服务器CPU市场
5.4.2 PC领域CPU市场
5.4.3 移动计算CPU市场
5.5 CPU行业代表企业CPU产品业务分析
5.5.1 AMD CPU产品分析
5.5.2 英特尔CPU产品分析
5.5.3 苹果CPU产品分析
第六章 2016-2020年高性能GPU行业发展分析
6.1 GPU基本介绍
6.1.1 GPU概念阐述
6.1.2 GPU的微架构
6.1.3 GPU的API介绍
6.1.4 GPU显存介绍
6.1.5 GPU主要分类
6.2 高性能GPU演变分析
6.2.1 GPU技术发展历程
6.2.2 GPU微架构进化过程
6.2.3 先进制造升级历程
6.2.4 主流高端GPU发展
6.3 高性能GPU市场分析
6.3.1 GPU产业链条分析
6.3.2 全球GPU发展现状
6.3.3 全球供需情况概述
6.3.4 国产GPU发展情况

6.3.5 国内GPU企业布局
6.3.6 国内高端GPU研发
6.4 GPU细分市场分析
6.4.1 服务器GPU市场
6.4.2 移动电子GPU市场
6.4.3 PC领域GPU市场
6.4.4 AI领域GPU芯片市场
6.5 高性能GPU行业代表企业产品分析
6.5.1 英伟达GPU产品分析
6.5.2 AMD GPU产品分析
6.5.3 英特尔GPU产品分析
第七章 2016-2020年FPGA芯片行业发展综述
7.1 FPGA芯片概况综述
7.1.1 定义及物理结构
7.1.2 芯片特点与分类
7.1.3 不同芯片的区别
7.1.4 FPGA技术分析
7.2 FPGA芯片行业产业链分析
7.2.1 FPGA市场上游分析
7.2.2 FPGA市场中游分析
7.2.3 FPGA市场下游分析
7.3 全球FPGA芯片市场发展分析
7.3.1 FPAG市场发展现状
7.3.2 FPGA全球竞争情况
7.3.3 AI领域FPGA的发展
7.3.4 FPGA芯片发展趋势
7.4 中国FPGA芯片市场发展分析
7.4.1 中国FPGA市场规模
7.4.2 中国FPGA竞争格局
7.4.3 中国FPGA企业现状
第八章 2016-2020年存储芯片行业发展分析
8.1 存储芯片发展概述
8.1.1 存储芯片定义及分类
8.1.2 存储芯片产业链构成
8.1.3 存储芯片技术发展

8.2 存储芯片市场发展情况分析
8.2.1 存储芯片行业驱动因素
8.2.2 全球存储芯片发展规模
8.2.3 中国存储芯片销售规模
8.2.4 国产存储芯片发展现状
8.2.5 存储芯片行业发展趋势
8.3 高端DRAM芯片市场分析
8.3.1 高端DRAM概念界定
8.3.2 DRAM芯片产品分类
8.3.3 DRAM芯片应用领域
8.3.4 DRAM芯片市场现状
8.3.5 DRAM市场需求态势
8.3.6 企业高端DRAM布局
8.3.7 高端DRAM工艺发展
8.3.8 国产DRAM研发动态
8.3.9 DRAM技术发展潜力
8.4 高性能NAND Flash市场分析
8.4.1 NAND Flash概念
8.4.2 NAND Flash技术路线
8.4.3 NAND Flash市场发展规模
8.4.4 NAND Flash市场竞争情况
8.4.5 NAND Flash需求业态分析
8.4.6 高端NAND Flash研发热点
8.4.7 国内NAND Flash代表企业
第九章 2016-2020年人工智能芯片行业发展分析
9.1 人工智能芯片概述
9.1.1 人工智能芯片分类
9.1.2 人工智能芯片主要类型
9.1.3 人工智能芯片对比分析
9.1.4 人工智能芯片产业链
9.2 人工智能芯片行业发展情况
9.2.1 全球AI芯片市场规模
9.2.2 国内AI芯片发展现状
9.2.3 国内AI芯片主要应用
9.2.4 国产AI芯片厂商分布

9.2.5 国内主要AI芯片厂商
9.3 人工智能芯片在汽车行业应用分析
9.3.1 AI芯片智能汽车应用
9.3.2 车规级芯片标准概述
9.3.3 汽车AI芯片市场格局
9.3.4 汽车AI芯片国外龙头企业
9.3.5 汽车AI芯片国内龙头企业
9.3.6 智能座舱芯片发展
9.3.7 自动驾驶芯片发展
9.4 云端人工智能芯片发展解析
9.4.1 云端AI芯片市场需求
9.4.2 云端AI芯片主要企业
9.4.3 互联网企业布局分析
9.4.4 云端AI芯片发展动态
9.5 边缘人工智能芯片发展情况
9.5.1 边缘AI使用场景
9.5.2 边缘AI芯片市场需求
9.5.3 边缘AI芯片市场现状
9.5.4 边缘AI芯片主要企业
9.5.5 边缘AI芯片市场前景
9.6 人工智能芯片行业未来发展趋势
9.6.1 AI芯片未来技术趋势
9.6.2 边缘智能芯片市场机遇
9.6.3 终端智能计算能力预测
9.6.4 智能芯片一体化生态发展
第十章 2016-2020年5G芯片行业发展分析
10.1 5G芯片行业发展分析
10.1.1 5G芯片分类
10.1.2 5G芯片产业链
10.1.3 5G芯片发展历程
10.1.4 5G芯片市场需求
10.1.5 5G芯片行业现状
10.1.6 5G芯片市场竞争
10.1.7 5G芯片企业布局
10.2 5G基带芯片市场发展情况

10.2.1 基带芯片基本定义
10.2.2 基带芯片组成部分
10.2.3 基带芯片基本架构
10.2.4 基带芯片市场现状
10.2.5 基带芯片竞争现状
10.2.6 国产基带芯片发展
10.3 5G射频芯片市场发展情况
10.3.1 射频芯片基本介绍
10.3.2 射频芯片组成部分
10.3.3 射频芯片发展现状
10.3.4 射频芯片企业布局
10.3.5 射频芯片研发动态
10.3.6 射频芯片技术壁垒
10.3.7 射频芯片市场空间
10.4 5G物联网芯片市场发展情况
10.4.1 物联网芯片重要地位
10.4.2 5G时代物联网通信
10.4.3 5G物联网芯片布局
10.5 5G芯片产业未来发展前景分析
10.5.1 5G行业趋势分析
10.5.2 5G芯片市场趋势
10.5.3 5G芯片应用前景
第十一章 2016-2020年光通信芯片行业发展分析
11.1 光通信芯片相关概述
11.1.1 光通信芯片介绍
11.1.2 光通信芯片分类
11.1.3 光通信芯片产业链
11.2 光通信芯片产业发展情况
11.2.1 光通信芯片产业发展现状
11.2.2 光通信芯片技术发展态势
11.2.3 光通信芯片产业主要企业
11.2.4 高端光通信芯片竞争格局
11.2.5 高端光通信芯片研发动态
11.3 光通信芯片行业投融资潜力分析
11.3.1 行业投融资情况

11.3.2 行业项目投资案例
11.3.3 行业项目投资动态
11.4 光通信芯片行业发展趋势
11.4.1 国产替代规划
11.4.2 行业发展机遇
11.4.3 行业发展趋势
11.4.4 产品发展趋势
第十二章 2016-2020年其他高端芯片市场发展分析
12.1 高精度ADC芯片市场分析
12.1.1 ADC芯片概述
12.1.2 ADC芯片技术分析
12.1.3 ADC芯片设计架构
12.1.4 ADC芯片市场需求
12.1.5 ADC芯片主要市场
12.1.6 高端ADC芯片市场格局
12.1.7 国产高端ADC芯片发展
12.1.8 高端ADC芯片进入壁垒
12.2 高端MCU芯片市场分析
12.2.1 MCU芯片发展概况
12.2.2 MCU芯片市场规模
12.2.3 MCU芯片竞争格局
12.2.4 国产高端MCU芯片发展
12.2.5 智能MCU芯片发展分析
12.3 ASIC芯片市场运行情况
12.3.1 ASIC芯片定义及分类
12.3.2 ASIC芯片应用领域
12.3.3 ASIC芯片技术升级现状
12.3.4 人工智能ASIC芯片应用
第十三章 2016-2020年国际高端芯片行业主要企业运营情况
13.1 高通
13.2 三星
13.3 英特尔
13.4 英伟达
13.5 AMD
13.6 联发科

第十四章 2016-2020年国内高端芯片行业主要企业运营情况
14.1 海思半导体
14.1.1 企业发展概况
14.1.2 产品发展分析
14.1.3 服务领域分析
14.1.4 企业营收情况
14.2 紫光展锐
14.2.1 企业发展概况
14.2.2 企业主要产品
14.2.3 5G芯片业务发展
14.2.4 手机芯片技术动态
14.3 光迅科技
14.3.1 企业发展概况
14.3.2 经营效益分析
14.3.3 业务经营分析
14.3.4 财务状况分析
14.3.5 核心竞争力分析
14.3.6 公司发展战略
14.3.7 未来前景展望
14.4 寒武纪科技
14.4.1 企业发展概况
14.4.2 经营效益分析
14.4.3 业务经营分析
14.4.4 财务状况分析
14.4.5 核心竞争力分析
14.4.6 公司发展战略
14.4.7 未来前景展望
14.5 盛景微电子
14.5.1 企业发展概况
14.5.2 经营效益分析
14.5.3 业务经营分析
14.5.4 财务状况分析
14.5.5 核心竞争力分析
14.5.6 公司发展战略
14.5.7 未来前景展望

14.6 兆易创新
14.6.1 企业发展概况
14.6.2 经营效益分析
14.6.3 业务经营分析
14.6.4 财务状况分析
14.6.5 核心竞争力分析
14.6.6 公司发展战略
14.6.7 未来前景展望
第十五章 2021-2026年高端芯片行业投融资分析及发展前景预测
15.1 中国高端芯片行业投融资环境(AK HT)
15.1.1 美方制裁加速投资
15.1.2 社会资本推动作用
15.1.3 大基金投融资情况
15.1.4 地方政府产业布局
15.1.5 设备资本市场情况
15.2 中国高端芯片行业投融资分析
15.2.1 高端芯片行业投融资态势
15.2.2 高端芯片行业投融资动态
15.2.3 高端芯片行业投融资趋势
15.2.4 高端芯片行业投融资壁垒
15.3 国际高端芯片行业未来发展趋势
15.3.1 全球高端芯片行业技术趋势
15.3.2 中国高端芯片行业增长趋势
15.3.3 中国高端芯片行业发展前景
15.4 中国高端芯片行业应用市场展望
15.4.1 5G手机市场需求强劲
15.4.2 服务器市场保持涨势
15.4.3 PC电脑市场需求旺盛
15.4.4 智能汽车市场稳步发展
15.4.5 智能家居市场快速发展
图表目录：
图表：2020导体销售规模地域分布
图表：中国存储器芯片行业技术发展分析
图表：传统内存处理与物联网内存处理方案对比
图表：2021-2026年全球存储芯片市场规模及预测

图表：2016-2020年中国存储器芯片行业市场规模
图表：2021-2026年DRAM需求供给情况及预测
图表：2016-2020年全球NAND市场规模
图表：2016-2020年各NAND厂商占比情况
更多图表见正文……

详细请访问：https://www.huaon.com//channel/electric/738026.html